

深南电路股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、行业格局及发展趋势

深南电路拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务，公司已成为中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业。

1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据Prismark2022年第四季度报告统计，2022年以美元计价的全球PCB产业产值同比上升1%。

从中长期看，产业将保持稳定增长的态势。2022年-2027年全球PCB产值的预计年复合增长率达3.8%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为3.3%，增长保持稳健。从产品结构看，封装基板、HDI板、18层及以上的高多层板、8-16层的高多层板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。

2022-2027 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2021	2022E		2027E	2022-2027E
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美洲	3,245	3.8%	3,369	4,129	4.2%
欧洲	2,003	-5.9%	1,885	2,250	3.6%
日本	7,310	-0.4%	7,280	8,414	2.9%
中国大陆	44,143	-1.4%	42,553	51,133	3.3%
亚洲（日本、中国大陆除外）	24,207	5.9%	25,654	32,462	4.8%
合计	80,910	1.0%	81,740	98,388	3.8%

数据来源：Prismark 2022 Q4 报告

对于封装基板产品，5G 通信、人工智能、云计算、自动驾驶、智能穿戴、智能家居、万物互联等产品技术升级与应用场景拓展，驱动电子产业对芯片和先进封装需求的大幅增长，从而间接带动了全球封装基板产业的发展。

对于 PCB 产品，无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。伴随 5G 时代下物联网、AI、智

能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升 PCB 用量的同时，也进一步驱动 PCB 向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展。高多层、高频高速、HDI 等中高阶 PCB 产品的需求将继续保持较好增长。

2、电子装联行业发展状况

电子装联在行业上属于EMS行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球EMS行业的市场集中度相对较高，国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外服务的能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力也逐渐成为电子装联行业的核心竞争力之一。

2022 年以来，全球多个国家、地区的防疫管控政策逐步放松，生产物流有所恢复，叠加下半年以消费电子为代表的终端需求下滑，电子产业的芯片与其他电子元器件供应环境整体上有所改善，但汽车与工控领域部分高端芯片结构性短缺仍然存在。

二、公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕“3-In-One”战略，发挥业务协同优势将核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥公司电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为受客户认可的电子互联技术领导者。

三、2023 年经营计划

从宏观层面看，根据世界银行最新发布的 2023 年全球经济展望显示，预计 2023 年全球经济增速为 1.7%，相较 2022 年增速 2.9% 下滑约 1.2 个百分点。其中美欧日等海外发达经济体经济增速预计将由 22 年的 2.5% 下滑至 0.5%，而中国经济增速预计将上浮至 4.3%。公司及行业将面临更大的挑战。

公司 2023 年将继续坚持“3-In-One”战略，积极应对宏观经济上可能存在的
不利因素，以客户开发、订单获取、能力提升为关键目标，确保各项业务稳健经营；
持续推进内部精益改善，提升运营效率，积极推进绿色低碳相关举措，践行社会
责任，以高水平治理推动公司的高质量发展。

在市场开拓方面，公司将重点聚焦各业务领域的新客户开发进度，同时积极
争取现有成熟客户的增量订单；在快速响应海外客户需求，扩充海外订单规模的
同时，持续关注并挖掘国内市场存在的结构性机会。

在能力提升方面，公司将继续通过突破技术瓶颈、提高质量管理水平，加强
成本费用管控等举措，强化技术与成本竞争力，双向推动各项业务实现规模与利
润的预期目标。

在运营管理方面，公司将持续深入推进流程变革与数字化转型工作，深化落
实从产品、制程、设备、运营、流程等维度的数字化协同管理举措，加快向流程
型组织转变。

在投资项目建设方面，公司将积极推进广州封装基板项目建设，确保一期项
目按期连线投产；持续提升无锡基板二期、南通三期项目的产线能力，结合下游
市场情况稳步推进项目产能爬坡。

在可持续发展方面，公司将继续开展 ESG 实践，推进绿色低碳运营，提供
创新可持续的产品与服务，提升企业综合治理水平。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日